

## 关键指标

频率：0.4~2.6GHz  
增益：23dB@1GHz  
噪声系数：0.8dB@1GHz  
1dB 压缩点输出功率：21dBm  
电压/静态电流：+4V/76mA，+5V/108mA  
芯片尺寸：1.1mm×1.3mm

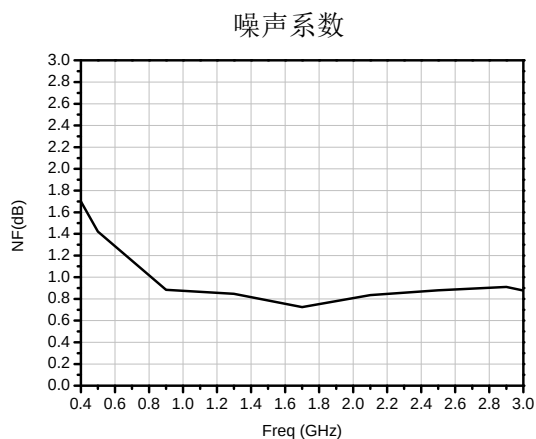
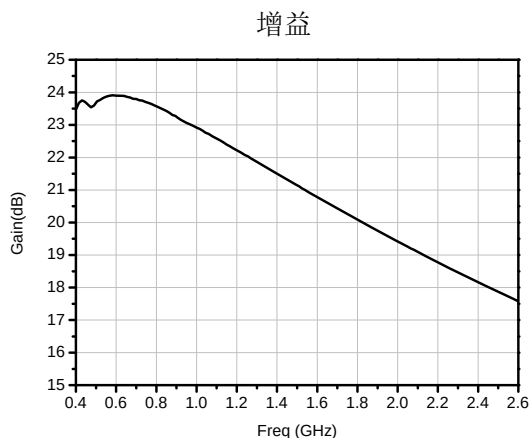
## 产品简介

该产品是一款 0.4~2.6GHz 型低噪声放大器芯片，该芯片单电源供电，+4V 加电时，静态电流为 76mA；+5V 加电时，静态电流为 108mA，射频输入输出端均有隔直电容。

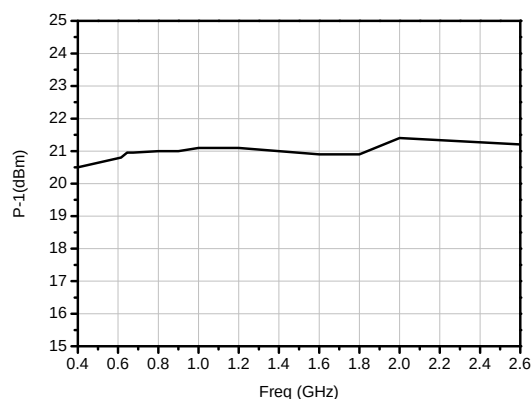
## 电性能 (TA=25℃, Vdd=+4V)

| 指标               | 最小值     | 典型值     | 最大值 |
|------------------|---------|---------|-----|
| 频率(GHz)          | 0.4~2.6 |         |     |
| 增益(dB)           | —       | 23@1GHz | —   |
| 增益平坦度(dB)        | —       | ±3      | —   |
| 输入驻波             | —       | 1.4     | —   |
| 输出驻波             | —       | 1.6     | —   |
| 噪声系数(dB)         | —       | 0.8     | —   |
| 1dB 压缩点输出功率(dBm) | —       | 21      | —   |

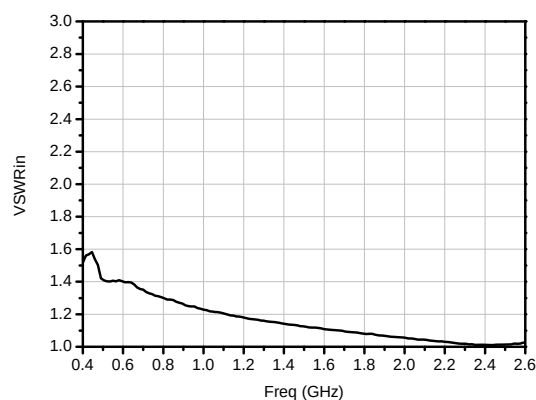
## 典型测试曲线 (+4V)



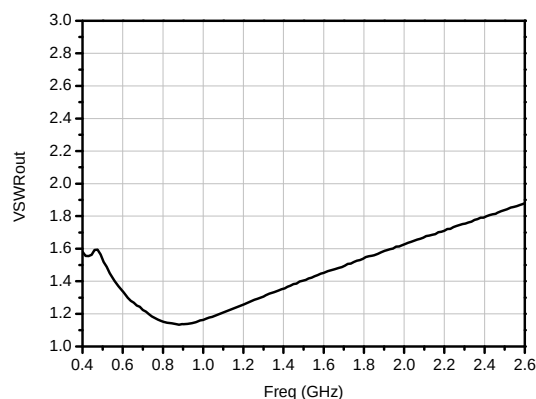
## 1dB 压缩点输出功率@4V



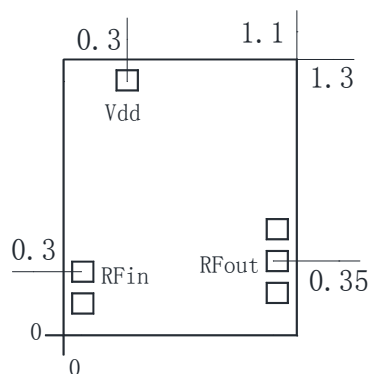
## 输入驻波



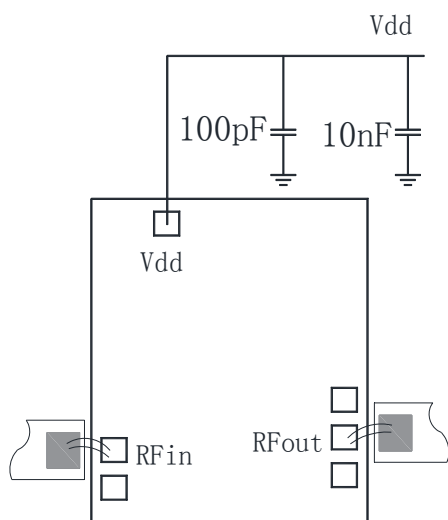
## 输出驻波



## 外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



### 绝对额定最大值

|        |           |
|--------|-----------|
| 工作电压   | +7V       |
| 最大输入功率 | +18dBm    |
| 工作温度   | -55℃～125℃ |
| 存储温度   | -65℃～150℃ |

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250～400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片输入输出端均有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

V2.0(3501)